

超配 (维持)

MLCC 行业深度报告

供需矛盾加剧，高阶 MLCC 价格有望上扬

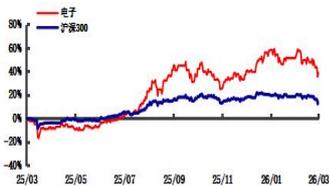
2026 年 3 月 25 日

投资要点：

罗炜斌
SAC 执业证书编号：
S0340521020001
电话：0769-22110619
邮箱：
luoweibin@dgzq.com.cn

■ **MLCC下游应用领域广泛，国产替代空间巨大。**MLCC具有温度范围宽、电容范围宽、介质损耗小、体积小、价格低等特点，广泛应用于移动终端、高端装备、汽车、计算机、通信、家电等多个领域，目前朝向小型化、高容量趋势发展。从全球竞争格局来看，第一梯队以日本、韩国厂商为主，具备深厚的技术、产品、客户积累，以小尺寸、高容、高压的高附加值产品为主，聚焦于汽车、高端智能手机、AI服务器等领域；第二、第三梯队分别以中国台湾和中国大陆厂商为主，大陆厂商技术水平相较于日系、韩系厂商仍有差距，以中大尺寸、低容产品为主，但近年通过技术突破推出多款小尺寸、高容量产品，并且进一步突破汽车、通信、工控、AI等领域。随着全球地缘环境渐趋复杂，国产终端厂商越来越重视零部件的自主可控，进一步加快扶持国产供应链，MLCC国产替代空间十分广阔。以2025年进口数量计算，若替代50%，MLCC国产替代规模将高达1.28万亿个。

电子行业指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

相关报告

■ **供需矛盾加剧，高阶MLCC价格有望上扬。**AI加大对高容、高压、宽温、小型化MLCC的需求，村田高管在25Q3业绩说明会表示AI服务器产品堆叠层数较大，而堆叠层数增加将会进一步加大产能消耗，同时高端MLCC制造工艺复杂、良率相较于常规品更低，整体产能消耗将更大。目前村田、三星电机等厂商已经处于满载状态，且今年新增高端产能有限，面对AI领域旺盛需求，高容MLCC产品交期已经拉长，供需矛盾可能会进一步加剧。村田高管2月指出MLCC订单询问量是目前产能的2倍，3月决定4月开始对AI服务器和高端车规级MLCC产品全面涨价，涨幅在15%-35%。而三星电机则计划在4月开始提高MLCC价格，涨幅可能达到双位数百分比。内资厂商风华高科、三环集团深耕行业多年，积极突破高端领域，亦有望受益此轮高端MLCC供需不均衡所带来的涨价潮。

■ **风险提示：AI需求不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧。**

目 录

1. MLCC 下游应用领域广泛，国产替代空间巨大	4
2. 供需矛盾加剧，高阶 MLCC 价格有望上扬	11
3. 风险提示	16

插图目录

图 1：被动元件分类	4
图 2：被动元件下游应用占比	4
图 3：被动元件产品结构	5
图 4：陶瓷电容产品结构	6
图 5：MLCC 结构	6
图 6：MLCC 下游应用	6
图 7：村田推出 006003 尺寸 MLCC	7
图 8：太阳诱电推出 1000 μ f 容量 MLCC	7
图 9：MLCC 工艺流程	7
图 10：全球 MLCC 陶瓷粉市场竞争格局	9
图 11：中国企业与日韩企业的技术差距	9
图 12：2024 年全球 MLCC 市场份额	10
图 13：2022 年全球车规级 MLCC 市场份额	10
图 14：中国 MLCC 进出口数量及金额	11
图 15：中国 MLCC 进出口单价	11
图 16：数据中心电力系统架构	11
图 17：日本村田关于电容需求预测	12
图 18：三星电机车规 MLCC	12
图 19：不同动力汽车所需 MLCC 数量	12
图 20：MLCC 广泛应用于机器人主要模块	13
图 21：人形机器人 MLCC 用量分析	13
图 22：村田 FY25Q1-FY25Q3 电容业务收入	13
图 23：村田整体及电容 B/B ratio	13
图 24：村田上修 FY2025 年业绩指引	13
图 25：村田存货情况	13
图 26：三星电机 2025Q1-Q4 电容产品收入	14
图 27：三星电机 25Q4 零件部门业绩变动情况	14
图 28：国巨 2025Q1-Q4 MLCC 产品收入	14
图 29：村田 Q1 元件交期及价格走势	15
图 30：太阳诱电 Q1 元件交期及价格走势	15
图 31：TDK Q1 元件交期及价格走势	15
图 32：三星电机 Q1 元件交期及价格走势	15
图 33：国巨 Q1 元件交期及价格走势	15
图 34：华新科 Q1 元件交期及价格走势	15

表格目录

表 1：按介质不同，对电容分类	5
表 2：MLCC 成本构成	8
表 3：钛酸钡制备方法	8

表 4：重点公司盈利预测及投资评级（截至 2026/3/24） 16

1. MLCC 下游应用领域广泛，国产替代空间巨大

1.1 MLCC 占被动元件主要份额，下游应用场景广泛

被动元件下游应用广泛。根据是否需要外部能量进行划分，电子元器件可以分为主动元件和被动元件。主动元件在工作时需要外部电源供应能量，具备对电信号放大、振荡、控制电流或能量分配等功能，主要包括集成电路、分立器件等。被动元件本身不需要电源而只消耗输入信号电能就可以进行信号处理和传输，具备不影响信号基本特征、仅令讯号通过而不加以更改的特征，主要 RCL 器件、被动射频器等。从下游应用来看，被动元件主要用于网络通信、汽车电子、电力与工业等领域，占比分别为 36%、15%和 10%。

图 1：被动元件分类



数据来源：中商产业研究院，东莞证券研究所

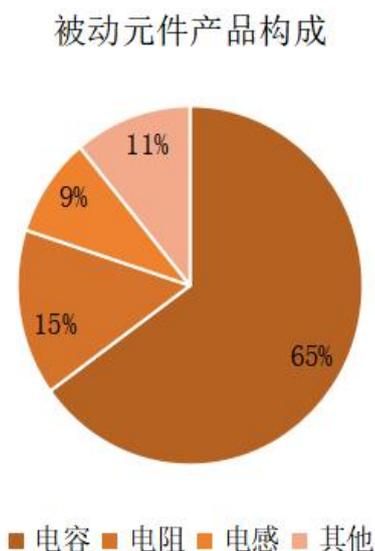
图 2：被动元件下游应用占比



数据来源：中商产业研究院，东莞证券研究所

被动元件以电容为主，MLCC 占主要份额。RCL 器件中电感主要具有滤波、稳流、抗电磁干扰等功能，电阻主要起到分压、分流、滤波和抗阻匹配等作用；而电容具有旁路、去耦、滤波和储能等功能，是被动元件最主要构成部分，2023 年占比达到 65%。根据介质不同，可分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容、薄膜电容等。相较于其他电容，陶瓷电容具有体积小、电压范围大、价格较低等特点，占据电容市场 54%的市场份额。

图 3：被动元件产品结构



数据来源：中商产业研究院，东莞证券研究所

表 1：按介质不同，对电容分类

类目	陶瓷电容	铝电解电容	钽电解电容	聚酯薄膜电容
容量	适中	较高	较高	较小
成本	适中	较低	适中	适中
紧凑程度	高	低	适中	低
频率特性	好	差	差	适中
温漂特性	适中	适中	适中	好
等效电阻	小	大	大	大
可靠性	高	较差	适中	较差
极性	无极性	有极性	有极性	无极性
耐压程度	高	低	适中	高
使用寿命	长	较短	适中	长
体积	小	大	适中	适中

数据来源：达利凯普招股说明书，中国电容器网，东莞证券研究所

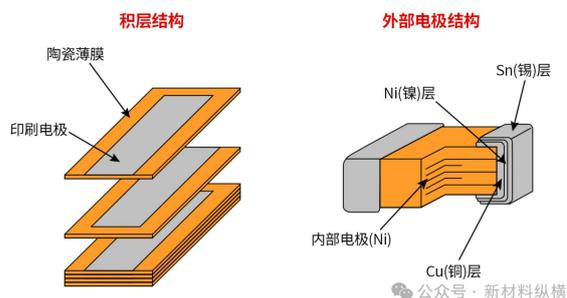
陶瓷电容可进一步划分为单层陶瓷电容、片式多层陶瓷电容（MLCC）、引线式多层陶瓷电容。其中 MLCC 包括内电极、陶瓷层、端电极三部分，由印好电极的陶瓷介质膜片以错位的方式堆叠起来，经过高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片两端封上金属层，从而形成类似于独石的结构体。相较于单层陶瓷电容、引线式多层陶瓷电容，MLCC 具有温度范围宽、电容范围宽、介质损耗小、体积小、价格低等特点，因此也被广泛应用，占据陶瓷电容超过 90% 的市场份额。从下游应用来看，MLCC 广泛应用于移动终端、高端装备、汽车、计算机、通信、家电等多个重要领域。

图 4：陶瓷电容产品结构



数据来源：达利凯普招股说明书，前瞻产业研究院，东莞证券研究所

图 5：MLCC 结构



数据来源：新材料纵横公众号，东莞证券研究所

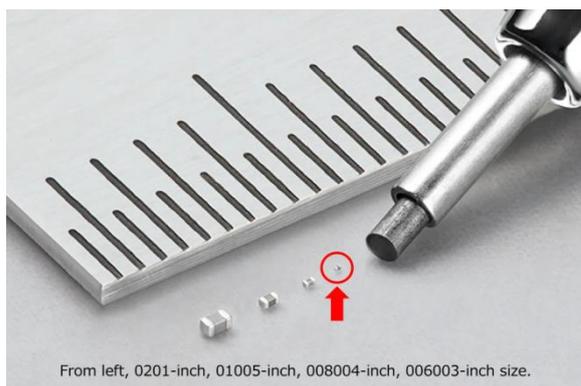
图 6：MLCC 下游应用



数据来源：中商产业研究院，东莞证券研究所

MLCC 朝向小型化、高容化趋势发展。智能手机、PC/平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品走向轻薄化，对电子元件的重量、尺寸提出更高要求，MLCC 从早期 1206、0805 规格逐步缩小至 0402、0201、01005 等规格，村田发布更小的 006003 (0.16mmx0.08mm) 规格产品，已经达到人眼无法辨别的尺寸，相较于 008004 体积缩小约 75%。同时 MLCC 呈现高容化趋势，能够对部分电解电容实现替代。太阳诱电推出 4532 尺寸 MLCC 容量高达 1000 μ f；据村田披露的数据，MLCC 容量体积比从 1996 年的 1 μ f/立方毫米增加至 2020 年的 40 μ f/立方毫米。

图 7：村田推出 006003 尺寸 MLCC



数据来源：村田中国公众号，东莞证券研究所

图 8：太阳诱电推出 1000 μf 容量 MLCC

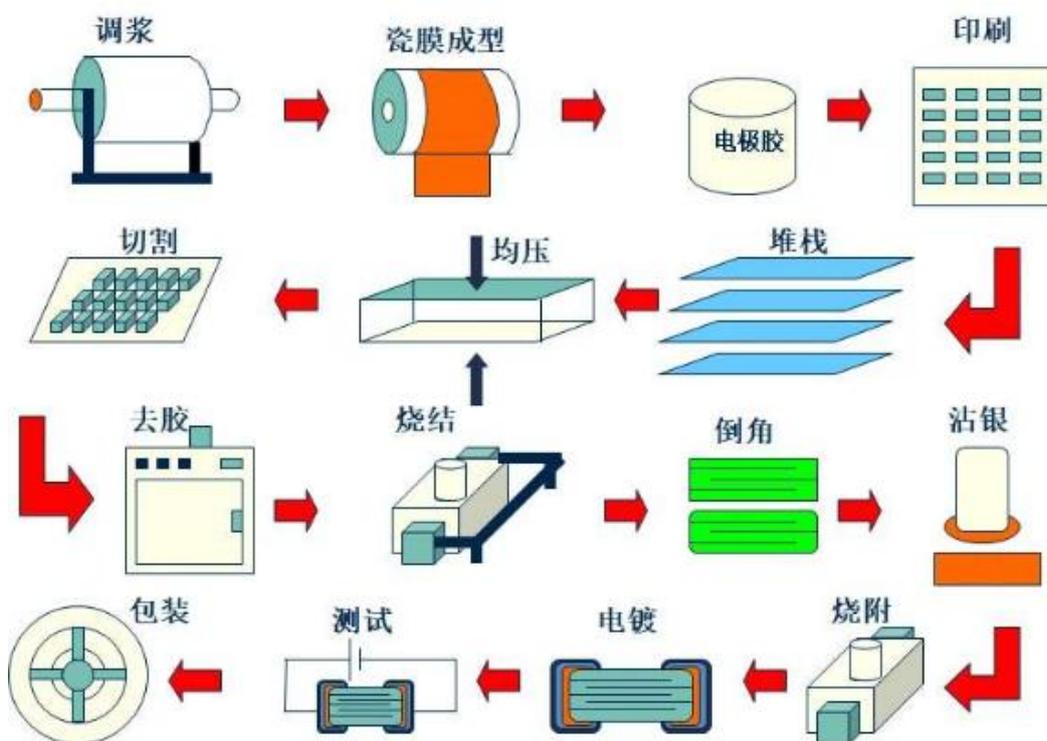


数据来源：太阳诱电官网，东莞证券研究所

1.2 MLCC 工艺流程对材料及技术壁垒要求较高

MLCC 工艺流程复杂。MLCC 制造涉及多个工艺流程，包括调浆、瓷膜成型、印刷、堆栈、均压、切割、去胶、烧结等数十道步骤，核心包括材料技术、叠层印刷技术和共烧技术等，相关技术直接影响产品最终性能。

图 9：MLCC 工艺流程



数据来源：艾邦半导体网，东莞证券研究所

陶瓷材料：从 MLCC 成本构成来看，陶瓷材料占比较高，在低容 MLCC 中占比为 20%-25%，在高容 MLCC 中占比达到 35%-45%。陶瓷粉体材料主要包括基础粉以及配方粉，由于钛酸钡具有高介电常数、低介电损耗等特点，被广泛用于制造陶瓷敏感元件的基础粉。钛酸钡主要有固相法、共沉淀法、溶胶-凝胶法、水热法等制备方法，不同方法将影响颗粒的微细度、均匀度等参数，从而影响 MLCC 产品性能，其中水热法制备的钛酸钡颗粒细

且均匀，能够用于高端 MLCC 产品生产，但成本也相应较高，目前日本堺化学、国瓷材料已具备批量生产销售的能力。

表 2：MLCC 成本构成

类目	低容 MLCC	高容 MLCC
陶瓷料	20%-25%	35%-45%
内电极（镍/银/钯）	5%	5%-10%
外电极（铜/银）	5%	5%-10%
包装材料	20%-30%	1%-5%
人工成本	10%-20%	10%-20%
设备折旧及其他	20%-35%	20%-30%

数据来源：新材料纵横公众号，东莞证券研究所

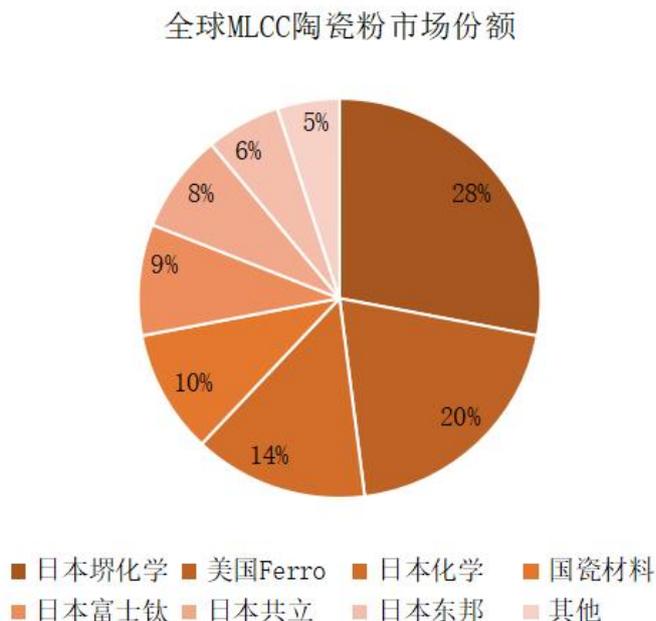
表 3：钛酸钡制备方法

类目	固相法	共沉淀法	溶胶-凝胶法	水热法
生产成本	低	中	高	高
适用范围	商用	商用、实验	实验	商用、实验
组分控制	差	好	极好	极好
形态控制	差	中	中	好
四方性	>1.0087	<1.0087	<1.0087	<1.0087
煅烧	要	要	要	不要
研磨	要	要	要	不要

数据来源：艾邦陶瓷展公众号，东莞证券研究所

陶瓷材料由于制备工艺复杂、研发周期长、下游客户验证壁垒等，全球竞争格局较为集中，CR5 达到 81%，且主要被日本、美国公司所垄断，其中日本堺化学、美国 Ferro 公司的市场份额分别达到 28%和 20%。随着技术水平不断提升、国产替代进程加速，国内生产陶瓷材料的企业逐渐增多、产量不断提升，包括国瓷、风华、三环等企业，其中国瓷材料凭借多年的技术积累，实现了所有类型的基础粉和配方粉的全面覆盖，下游客户包括三星电机、国巨、风华等。在高端领域，我国高端陶瓷粉体的技术仍有待进一步突破，目前日本企业钛酸钡的平均粒径能够做到 80-100nm，而国内企业能够做到的钛酸钡平均粒径为 120-150nm。

图 10：全球 MLCC 陶瓷粉市场竞争格局



数据来源：中商情报网，东莞证券研究所

叠层技术：MLCC 要提升电容量，除了可以改良陶瓷材料外，还可以通过降低介质厚度、增加 MLCC 内部叠层数实现。目前日本企业能够在单层 0.5-0.6 μm 的薄膜介质实现 1,200 层叠层，其中日本村田最高能够达到 1,600 层，而内资企业平均能够在单层介质厚度为 1-2 μm 的薄膜实现 800 层叠层，相较于海外仍然存在相当的技术差距，在同样尺寸下，内资企业所生产的 MLCC 电容要低于日系厂商。目前内资领军企业风华、三环 MLCC 产品的堆叠层数已经达到 1,000 层以上。

图 11：中国企业与日韩企业的技术差距



数据来源：三环集团，东莞证券研究所

共烧技术：MLCC 元件包括陶瓷介质、内电极金属层和外电极三层金属层，是由多层陶瓷介质印刷内电极浆料，叠合共烧而成。为此，不可避免地要解决不同收缩率的陶瓷介质

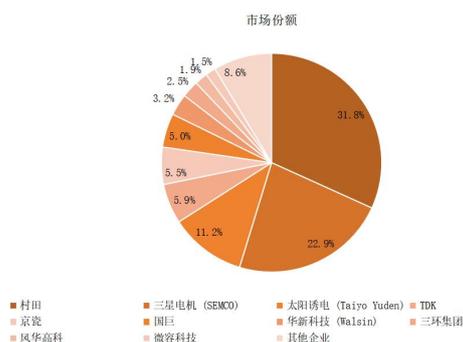
和内电极金属如何在高温烧成后不会分层、开裂，即陶瓷粉料和金属电极共烧问题。共烧技术就是解决这一难题的关键技术，掌握好的共烧技术可以生产出更薄介质、更高层数的 MLCC。现阶段日本公司在 MLCC 烧结专用设备技术方面领先，不仅有各式氮气气氛窑炉（钟罩炉和隧道炉），而且在设备自动化、精度方面有明显的优势。

1.3 行业主要分为三个梯队，日系企业市场份额领先

行业主要分为三个梯队。从全球竞争格局来看，第一梯队以日本、韩国厂商为主，在行业深耕多年，具备深厚的技术、产品、客户积累，以小尺寸、高容、高压的高附加值产品为主，聚焦于汽车、高端智能手机、AI 服务器等领域，代表厂商包括日本村田、韩国三星电机等。第二梯队以中国台湾厂商为主，产品矩阵较为丰富，主要集中在中低端领域，近年积极往汽车等高价值量领域发展，产能规模持续扩充，代表厂商包括国巨、华新科等。第三梯队则以中国大陆厂商为主，技术水平相较于日系、韩系厂商仍有差距，以中大尺寸、低容产品为主，但近年通过技术突破推出多款小尺寸、高容量产品，并且进一步突破汽车、通信、工控、AI 等领域，代表厂商如风华高科、三环集团等。

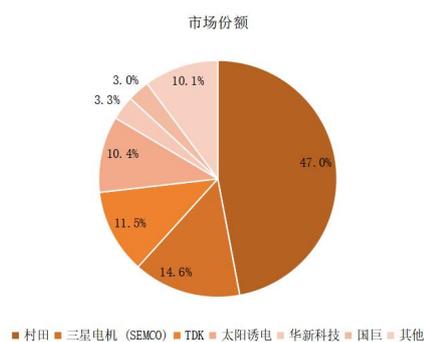
日系企业市场份额领先。2024 年全球 MLCC 市场份额 Top5 企业分别为村田、三星电机、太阳诱电、TDK、京瓷，日系企业占据 4 个席位，其中村田份额高达 31.8%。中国台湾的国巨、华新科紧随其后，市场份额分别为 5.0%和 3.2%；内资企业方面，三环集团、风华高科、微容科技上榜，市场份额分别为 2.5%、1.9%和 1.5%。高端产品方面，用于 AI 服务器领域的高端 MLCC 主要被村田、三星电机所把持，其中三星电机的市场份额约 40%（数据来源：韩国每日经济）。车规 MLCC 方面，主要由日系企业所垄断，2022 年出货量 Top4 厂商分别为村田、三星电机、TDK、太阳诱电，市场份额分别为 47.0%、14.6%、11.5%和 10.4%。

图 12：2024 年全球 MLCC 市场份额



数据来源：宏明电子招股书，东莞证券研究所

图 13：2022 年全球车规级 MLCC 市场份额



数据来源：华新科官网，东莞证券研究所

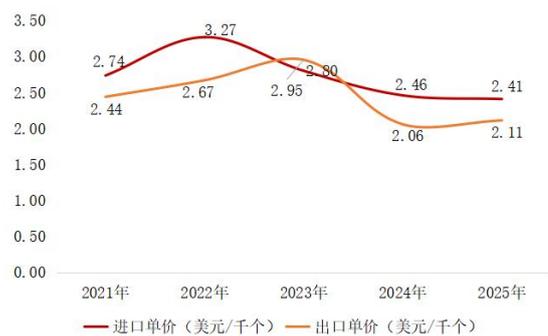
国产替代空间巨大。2025 年我国进口 MLCC 数量为 2.56 万亿个，进口金额为 61.79 亿美元。从单价来看，进口 MLCC 单价约为 2.41 美元/千只，高于 2.11 美元/千只的出口单价。随着全球地缘环境渐趋复杂，终端厂商越来越重视电子零部件的自主可控，加快扶持国产供应链，MLCC 国产替代空间十分广阔。以 2025 年进口数量计算，若替代 50%，MLCC 国产替代规模将高达 1.28 万亿个。

图 14：中国 MLCC 进出口数量及金额



数据来源：海关总署官网，东莞证券研究所

图 15：中国 MLCC 进出口单价

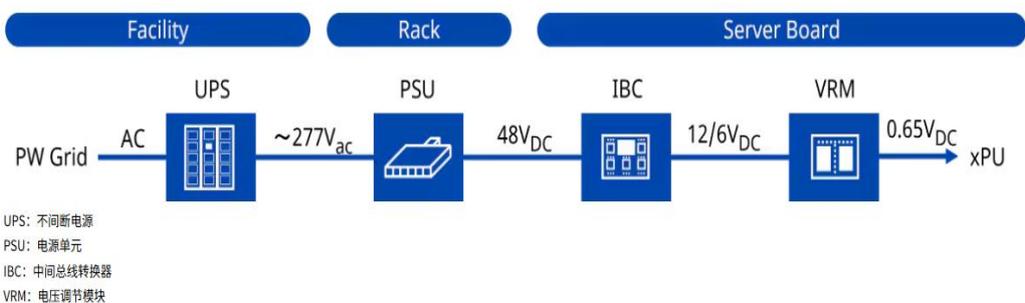


数据来源：海关总署官网，东莞证券研究所

2. 供需矛盾加剧，高阶 MLCC 价格有望上扬

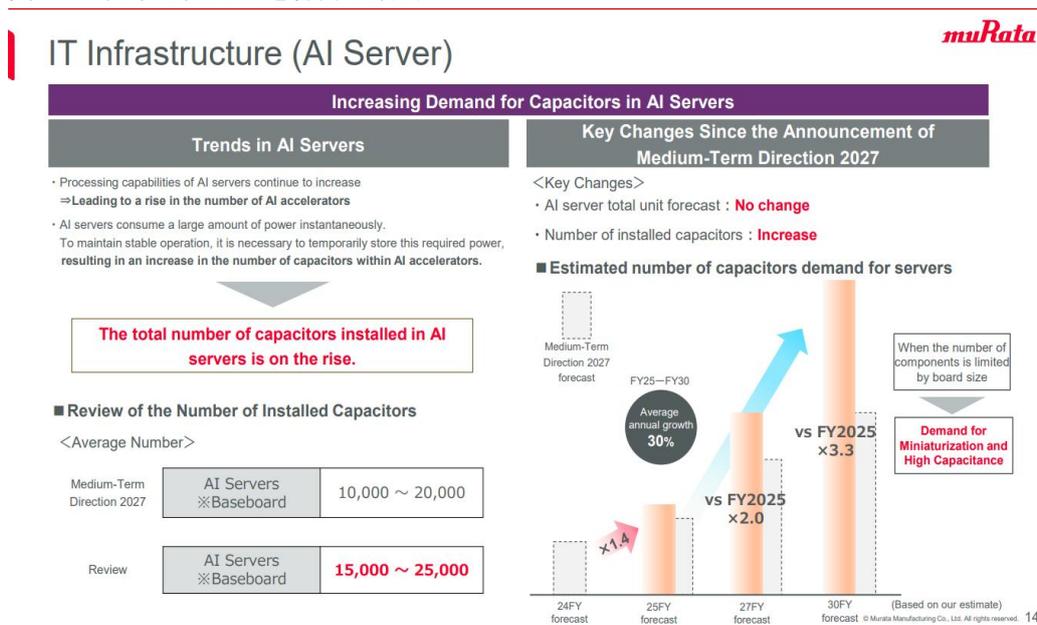
AI 数据中心驱动 MLCC 量价齐升。在 AI 数据中心的 MLCC 主要应用于电力系统、服务器机架、计算板、交换板等领域。以计算板为例，AI 芯片工作电压低、电流需求大且瞬时波动剧烈，需要 MLCC 实现就近去耦、瞬时补电功能，高容 MLCC 需求进一步加大；同时基板布线密度加大、功耗增加，也对 MLCC 的小型化、耐高温提出了更高要求，产品价值量相较于传统产品会大幅增加。从量角度来看，村田表示 GB300 平台需要搭载约 3 万颗 MLCC，约是手机的三十倍、汽车的三倍，单一机柜消耗量更高达 44 万颗。村田预计全球 2025-2030 年服务器电容需求将保持 30% 复合增速增长。

图 16：数据中心电力系统架构



数据来源：TDK 官网，东莞证券研究所

图 17: 日本村田关于电容需求预测



数据来源: 村田官网, 东莞证券研究所

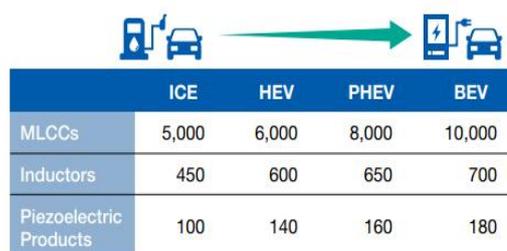
AI 终端加大高端 MLCC 需求。汽车电子方面, 汽车电动化、智能化驱动 MLCC 用量提升, 据 TDK 数据, 传统燃油汽车一般需要 5,000 颗 MLCC, 而混动、插电式混动、纯电动汽车分别需要 6,000、8,000、10,000 颗 MLCC, 同时车载 MLCC 需要用到高容、高温、高压、高可靠性等高端产品。具身智能方面, MLCC 广泛应用于机器人的控制系统、驱动系统等主要模块, 并且呈现出小尺寸、高电压、高容占比提升等趋势。智能眼镜方面, 据 Trendforce 数据, 智能眼镜正大量导入 01005 的 MLCC, 每副需求量达 150-200 颗。

图 18: 三星电机车规 MLCC



数据来源: 三星电机官网, 东莞证券研究所

图 19: 不同动力汽车所需 MLCC 数量



数据来源: TDK官网, 东莞证券研究所

图 20: MLCC 广泛应用于机器人主要模块



数据来源: 微容科技官网, 东莞证券研究所

图 21: 人形机器人 MLCC 用量分析



数据来源: 微容科技官网, 东莞证券研究所

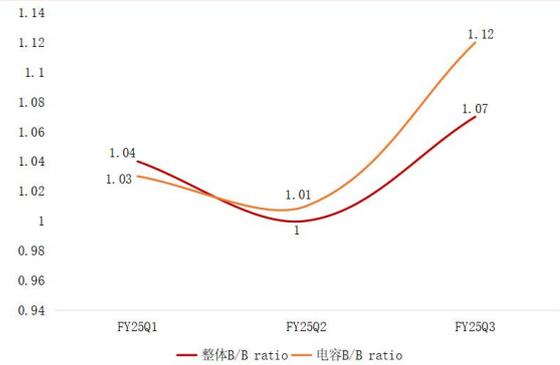
下游需求旺盛, 稼动率维持高位。日本村田披露 FY25Q3 业绩, 营业收入为 4,675 亿日元, 其中电容业务收入 2,391 亿日元, 同比增长 12.2%, 主要受益于服务器对电容需求加大, 电容 B/B ratio 达到 1.12, 相较于 Q2 的 1.01 进一步提升。公司上调全年业绩指引, 从此前预期的 1.74 万亿日元上调至 1.80 万亿日元, 主要得益于日元贬值、AI 服务器搭载电子零件数量增加、手机产量增加等因素推动。据管理层介绍, 公司 Q3 产能利用率达到 90%-95%, 由于客户订单强劲, 公司库存并未如期累积, 并计划增加用于 AI 服务器领域的产品库存。

图 22: 村田 FY25Q1-FY25Q3 电容业务收入



数据来源: 村田官网, 东莞证券研究所

图 23: 村田整体及电容 B/B ratio



数据来源: 村田官网, 东莞证券研究所

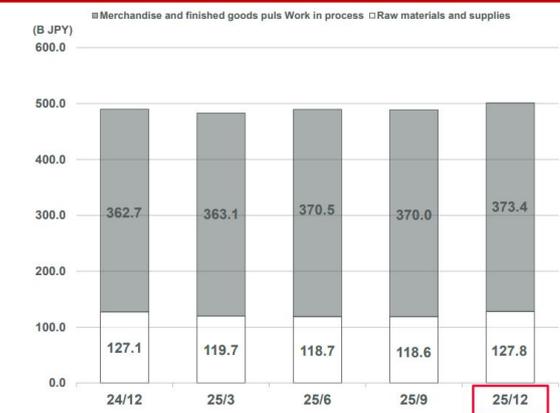
图 24: 村田上修 FY2025 年业绩指引

	FY2024			FY2025			FY2025		
	1st Half (B JPY)	2nd Half (B JPY)	Projection (October) (%)	1st Half (B JPY)	2nd Half (B JPY)	Projection (February) (%)	Projection (October) vs Projections (February) (B JPY)	Revised vs. Original (B JPY)	Constant Currency base (%)
Revenue	902.8	837.2	1,740.0	902.8	897.2	1,800.0	+60.0	+3.4	+35.4
Operating profit	165.1	114.9	280.0	165.1	104.9	270.0	(10.0)	(3.6)	+17.7
Profit before tax	174.8	115.2	290.0	174.8	119.2	294.0	+4.0	+1.4	
Profit attributable to owners of parent	132.4	87.6	220.0	132.4	87.7	220.0	+0.0	+0.0	
ROIC (post-tax basis) (%)			9.7			8.9			
Average exchange rates yen/US dollar			145.52			149.06			

*Exchange rate sensitivity(per 1 JPY/US change per year)
Revenue: 9.8 B JPY
Operating profit: 4.5 B JPY

数据来源: 村田官网, 东莞证券研究所

图 25: 村田存货情况



数据来源: 村田官网, 东莞证券研究所

韩国三星电机披露 25Q4 业绩，电子元件事业部营收 1.32 万亿韩元，同比增长 22%，其中电容产品收入 1.19 万亿韩元，同比增长 21%，主要受益于 AI 服务器及电源用 MLCC 产品驱动。据首尔经济日报数据，三星电机 25Q1 在韩国釜山、中国天津、菲律宾的 MLCC 工厂稼动率均超过 96%，Q3 更进一步提升至 99%，显示出下游需求极为旺盛。

图 26：三星电机 2025Q1-Q4 电容产品收入



数据来源：三星电机官网，东莞证券研究所

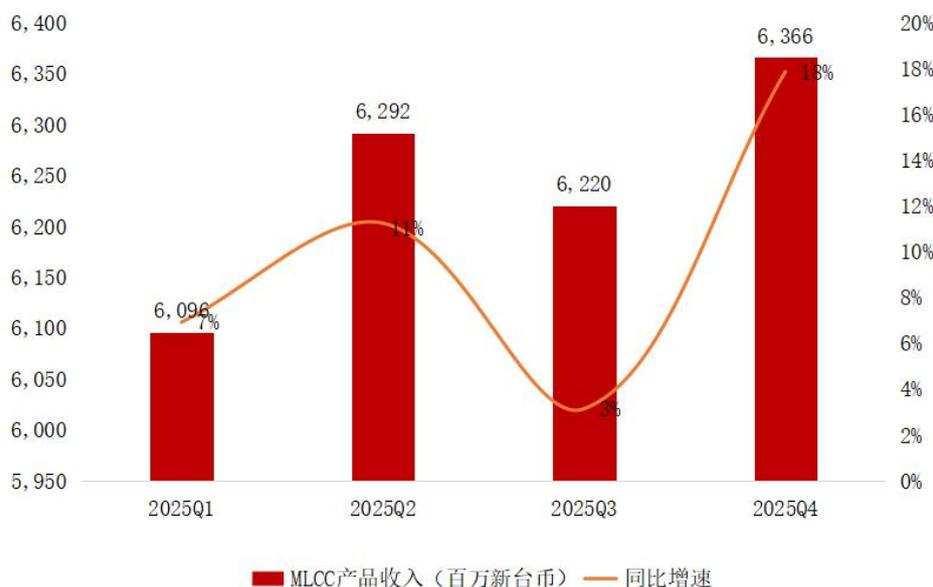
图 27：三星电机 25Q4 零件部门业绩变动情况



数据来源：三星电机官网，东莞证券研究所

中国台湾国巨披露 25Q4 业绩，营业收入为 359.68 亿新台币，其中 MLCC 产品收入 63.66 亿新台币，同比增长 18%。公司管理层在法说会表示，目前各终端市场的 B/B ratio 均维持在 1 以上，其中 AI 相关需求最为强劲，AI 服务器带动了高容 MLCC 与钽电容的增长。

图 28：国巨 2025Q1-Q4 MLCC 产品收入



数据来源：国巨官网，东莞证券研究所

Q1 MLCC 产品交期普遍拉长。据富昌电子数据，日本村田 Q1 高容（大于 1 μf）MLCC 产品交期约为 18-20 周、低容（小于 1 μf）MLCC 产品交期约为 10-14 周。太阳诱电高容 MLCC、低容 MLCC 产品交期分别为 20-22 周、10-14 周。韩国三星电机高容 MLCC、低容 MLCC 交期均为 20 周。台系方面，国巨高容和低容 MLCC 产品交期均为 22 周，华新科高容和低容 MLCC 产品交期均为 12-14 周。上述主要 MLCC 大厂的产品交期均出现拉长。

图 29：村田 Q1 元件交期及价格走势

muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS			
Murata	Lead Time	Trend	Pricing
Filters	12-16	↔	↗
Inductors / Transformers	8-12	↔	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	10-14	↗	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	18-20	↗	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	14-16	↗	↔
Leaded Capacitors - Ceramic	16-18	↗	↔
Specialty Capacitors	15-16	↗	↔

数据来源：富昌电子官网，东莞证券研究所

图 31：TDK Q1 元件交期及价格走势

TDK			
TDK	Lead Time	Trend	Pricing
Filters	10-14	↔	↔
Inductors / Transformers	16-20	↔	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	16-20	↗	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	20-24	↗	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	20-24	↗	↔

数据来源：富昌电子官网，东莞证券研究所

图 33：国巨 Q1 元件交期及价格走势

YAGEO Bulk Price Transparency			
YAGEO	Lead Time	Trend	Pricing
Thick Film Resistors	18-20	↔	↔
Thin Film Resistors	18-20	↔	↔
Current Sense Resistors	18-20	↔	↔
Resistor Networks	20-24	↔	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	22	↗	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	22	↗	↗
Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	22	↗	↔

① included transit time, shipment by boat

数据来源：富昌电子官网，东莞证券研究所

图 30：太阳诱电 Q1 元件交期及价格走势

TAIYO YUDEN			
TAIYO YUDEN	Lead Time	Trend	Pricing
Filters	15-17	↔	↔
Hybrid Aluminum Polymer Capacitors	24-33	↗	↔
Inductors / Transformers	6-9	↔	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	10-14	↗	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	20-22	↗	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	20-22	↗	↔

数据来源：富昌电子官网，东莞证券研究所

图 32：三星电机 Q1 元件交期及价格走势

SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS			
Samsung Electro-Mechanics	Lead Time	Trend	Pricing
Thick Film Resistors	44-46	↔	↔
Thin Film Resistors	44-46	↔	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	20	↗	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	20	↗	↔
Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	20	↗	↔

数据来源：富昌电子官网，东莞证券研究所

图 34：华新科 Q1 元件交期及价格走势

VISHAY The DNA of tech			
Vishay	Lead Time	Trend	Pricing
Trimmers & Pots	10-20	↔	↔
Capacitors - Film	12-20	↔	↔
Capacitors - Supercapacitors	12-14	↔	↔
Capacitors - Tantalum Molded	12-16	↗	↗
Capacitors - Tantalum Conformals	16-18	↗	↔
Capacitors - Polymer Tantalum <small>AI Impact on deliveries</small>	24-50	↗	↗
Inductors / Transformers	10-12	↔	↗
Thick Film Resistors	10-14	↔	↔
Thin Film Resistors	8-12	↔	↔
Current Sense Resistors	10-28	↗	↗
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	12-14	↗	↗
Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	12-14	↗	↗
Leaded Capacitors - Ceramic	12-16	↗	↗
Specialty Capacitors	16-20	↗	↗

数据来源：富昌电子官网，东莞证券研究所

高端 MLCC 供需矛盾加剧，价格有望进一步上扬。AI 加大对高容、高压、宽温、小型化 MLCC 的需求，村田高管在 25Q3 业绩说明会表示 AI 服务器产品堆叠层数较大，而堆叠层数增加将会进一步加大产能消耗，同时高端 MLCC 制造工艺复杂、良率相较于常规品更低，整体产能消耗将更大。目前村田、三星电机等厂商已经处于满载状态，且今年新增

高端产能有限，面对 AI 领域旺盛需求，高容 MLCC 产品交期已经拉长，供需矛盾可能会进一步加剧。村田高管 2 月指出 MLCC 订单询问量是目前产能的 2 倍，正在评估 AI 的实际需求，计划在 3 月底前做出是否涨价的决定；近期村田决定对 AI 服务器和高端车规级 MLCC 产品全面涨价，涨幅在 15%-35%，将于 4 月 1 日生效。而三星电机则计划在 4 月开始提高 MLCC 价格，涨幅可能达到双位数百分比。内资厂商风华高科、三环集团深耕行业多年，积极突破高端领域，亦有望受益此轮高端 MLCC 供需不均衡所带来的涨价潮。

表 4：重点公司盈利预测及投资评级（截至 2026/3/24）

代码	股票简称	股价（元）	EPS（元）			PE（倍）			评级	评级变动
			2024A	2025E	2026E	2024A	2025E	2026E		
000636.SZ	风华高科	20.10	0.29	0.31	0.42	68.93	64.84	47.86	买入	维持
300408.SZ	三环集团	54.24	1.14	1.40	1.71	47.46	38.74	31.72	买入	维持

资料来源：iFind，东莞证券研究所

3. 风险提示

AI 需求不及预期：AI 算力及终端对高阶 MLCC 需求大，若 AI 需求不及预期，将影响高阶 MLCC 出货量及价格，进而对相关公司业绩产生不利影响；

技术推进不及预期：高阶 MLCC 技术门槛较高，若技术推进不及预期，将影响产品出货，进而对相关公司业绩产生不利影响；

行业竞争加剧：若 MLCC 大厂大规模扩产高阶 MLCC 产能，可能会导致产品供过于求，影响产品价格，进而对相关公司业绩产生不利影响。

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，导致无法给出明确的投资评级；股票不在常规研究覆盖范围之内
行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明：本评级体系的“市场指数”，A股参照标的为沪深 300 指数；新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系

低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告，市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板（含退市整理期）等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告，港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系：“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报，“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报，“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报，“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报，“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券股份有限公司为全国综合性证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22115843

网址：www.dgzq.com.cn